

2021年5月14日

各 位

会社名 都築電気株式会社
代表者 代表取締役社長 江森 勲
(コード番号 8157 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員常務
平井 俊弘
(TEL 050-3684-7780)

電子デバイス事業の分社化（会社分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年10月1日（予定）を効力発生日として、電子デバイス事業を簡易吸収分割（以下、「本会社分割」という。）の方法により新設する子会社に承継することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社から100%子会社が事業を承継する吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

1. 本会社分割の目的

電子デバイス事業を取り巻く環境は、わが国半導体・電子部品製造業の相対的な競争力の低下やグローバルに活躍するメガディストリビュータの誕生などを背景に、年々厳しさを増しています。こうしたなかで競争力を維持し、事業価値を向上させていくためには、事業構造を大きく転換する必要があります。当社は、これまで進めてきた改革の取組みを更に加速し、①お客様・サプライヤ様との関係を最大限に生かした新たな事業モデルの創造と、②徹底した効率性/生産性の追求を進める方針であり、改革の果実を早期に獲得するために、経営判断の迅速化、当該事業の経営責任の明確化を目的に本件分社化を実施いたします。

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

取締役会決議日	2021年5月14日
吸収分割契約締結日	2021年7月1日（予定）
吸収分割効力発生日	2021年10月1日（予定）

(注)本会社分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割であり、当社の株主総会の承認を得ずに行います。

(2) 本会社分割の方式

本会社分割に向けた受け皿会社として、都築エンベデッドソリューションズ株式会社（以下、「都築エンベデッドソリューションズ」という。）を設立します。都築エンベデッドソリューションズを吸収分割承継会社とし、当社を吸収分割会社として、電子デバイス事業を吸収分割により承継いたします。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際して、都築エンベデッドソリューションズから当社への株式の割当、金銭その他の財産の交付はありません。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社が営む電子デバイス事業に関して有する権利義務を、当社と都築エンベデッドソリューションズとの間で締結する吸収分割契約書に定める範囲において効力発生日に承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割後における当社および都築エンベデッドソリューションズの債務履行の見込みについては、問題がないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社(設立時点(予定))
(1) 名称	都築電気株式会社	都築エンベデッドソリューションズ株式会社
(2) 所在地	東京都港区新橋 6-19-15	東京都港区西新橋 2-5-3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 江森 勲	代表取締役社長 戸澤 正人
(4) 事業内容	ネットワークシステムおよび情報システムの設計、開発、施工、保守	ICT 製品、電子機器、電子部品等の組み込み製品の販売・保守・サポートおよびオフィスサプライ品の販売
(5) 資本金	9,812 百万円	350 百万円
(6) 設立年月日	1941 年 3 月 26 日	2021 年 7 月 1 日 (予定)
(7) 発行済株式数	20,177,894 株	7,000 株 (予定)
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社麻生 22.30% 富士通株式会社 11.91% 都築電気従業員持株会 4.97% 扶桑電通株式会社 3.80% 株式会社三菱 UFJ 銀行 2.93% 株式会社みずほ銀行 2.93% 株式会社三井住友銀行 2.93%	都築電気株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績		
	都築電気(株) (連結)	都築エンベデッドソリューションズ(株)
決算期	2021 年 3 月期	—
純資産	31,171 百万円	—
総資産	76,200 百万円	—
1 株当たり連結純資産(円)	1,760 円 87 銭	—
売上高	120,004 百万円	—
営業利益	3,202 百万円	—
経常利益	3,361 百万円	—
親会社株主に帰属する当期純利益	2,346 百万円	—
1 株当たり連結当期純利益	134 円 06 銭	—

*承継会社は今後設立予定であり、直前事業年度の財政状態および経営成績はございません。

[分割する事業部門の概要]

(1) 分割する部門の事業内容

ICT 製品、電子機器、電子部品等の組み込み製品の販売・保守・サポートおよびオフィスサプライ品の販売。主な取扱商品は、組込サーバ機器、CPU ボード、SSD、HDD、半導体、電子部品、液晶パネル、FAN、ARM ツール、組込ソフト開発、カスタム LSI 開発等。

(2) 分割する部門の経営成績 (2021 年 3 月期)

売上高	20,520 百万円
部門利益	205 百万円

(注) 上記金額は、部門間取引は消去しておりません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

資産合計	10,696 百万円
負債合計	1,250 百万円

(注) 上記金額は、2021 年 3 月末現在の貸借対照表に基づき算出した概算値であり、分割する資産および負債については、上記金額に効力発生日までの増減を加減し確定いたします。

4. 本会社分割後の状況

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

都築エンベデッドソリューションズの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はない予定です。

5. 今後の見通し

本会社分割による当社連結業績への影響は軽微です。なお、今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以 上